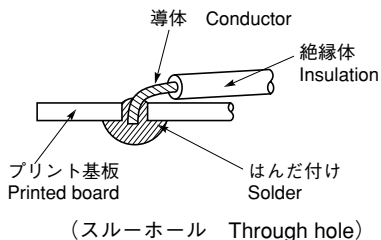


9 技術資料
Technical data

2 導体
Conductor

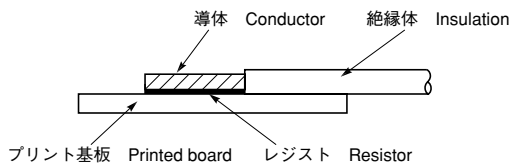
導体の主な接続方法 Typical connection methods

■はんだ付け(単線・より線・ハイラップワイヤ) Soldering (Solid conductor, Stranded conductor, TASC)



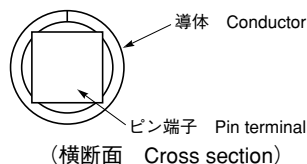
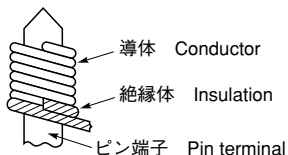
注) はんだ付けの場合、はんだ濡れ性向上のため、めっき付導体(すず、銀めっき等)をご使用ください。はんだ付け性の試験方法としては、JIS C 5402 (1992) 等があります。

NB. When attaching by soldering, in order to improve the solderability, use a plated conductor (tin, silver etc.) As a testing method for soldering properties there is the JIS C 5402 (1992) etc.



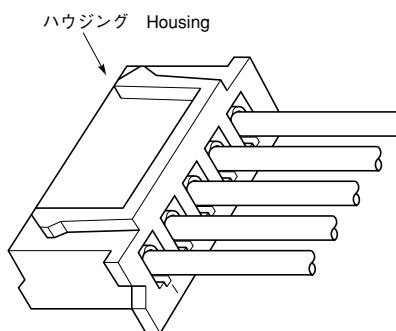
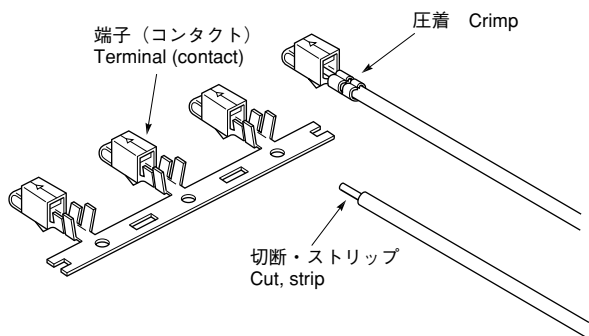
(SMT: 表面実装 Surface mount technology)

■ラッピング(単線・ハイラップワイヤ) Wrapping (Solid conductor, TASC)



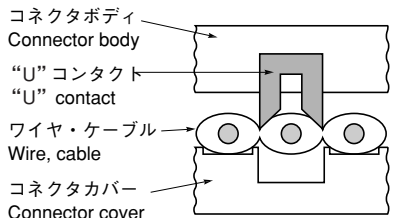
■圧着接続(より線) Crimping (Stranded conductor)

測長, 切断, ストリップ, 圧着 → ハウジング挿入
Length measurement, cutting, strip, crimping → inserted into housing.

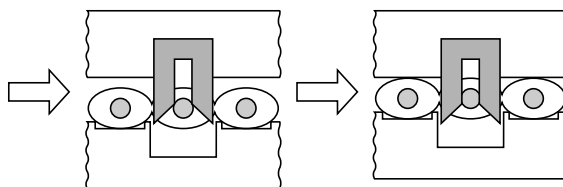


■圧着接続(単線・より線(主に7本より)・ハイラップワイヤ)

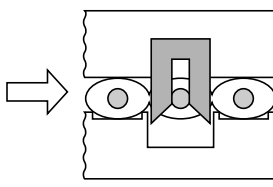
IDC (Insulation displacement contact) (Solid conductor, Stranded conductor (mainly 7 strands), TASC)
絶縁体無剥離接続(ワンタッチ接続)



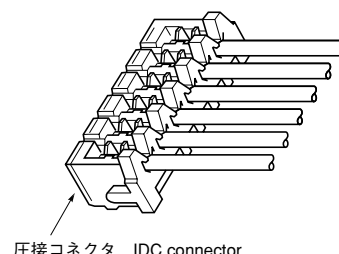
(1) コネクタカバーの溝の部分にケーブルの山部を合せる。
The cable is adjusted to fit the connector cover slot.



(2) ケーブルの上よりコネクタボディ(いわゆる"U"コンタクト)を載せ上方からプレスする。
The connector body("U" contact) mounts the top of the cable & pushes down on it from above.



(3) "U"コンタクトのテーパー部で絶縁体がえぐりとられ"U"スロットの内面で導体が保持される。
The conductor is held inside the gouged out "U" slot in the insulating body with the tapered ends of the "U" contact.

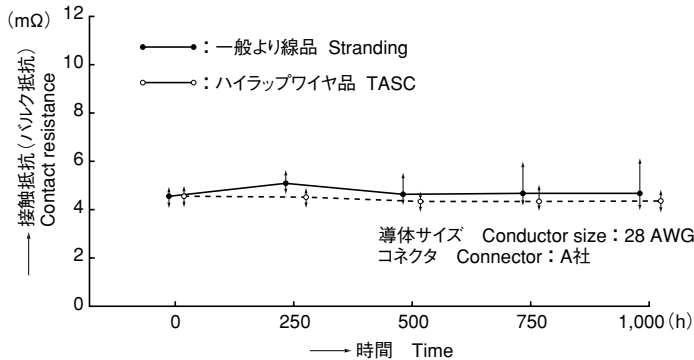


導体の主な接続方法 Typical connection methods

ハイラップ導体品の接触抵抗について Regarding contact resistance

圧接接続用 (IDC) 導体として、一般より線と一括せずコーティング (商品名: ハイラップワイヤ, 略号=TASC) の2種類を揃えています。ハイラップワイヤ品の場合、下図に示すとおり、一般より線品に比べ接触抵抗の経時変化も少なく、ばらつきが小さくなっています。

Stranded & bundled tin coated conductors (Product name : Hi-Wrap Wire, abbreviated form : TASC) are the two types generally used as IDC conductors. As shown in the graph opposite, when comparing TASC conductor products to the stranded products, the TASC conductor products contact resistance changes less over time & scattering also became less.



85°Cにおける接触抵抗の経時変化
85°C was maintained over the time when the contact resistance changed.